

### 产品介绍

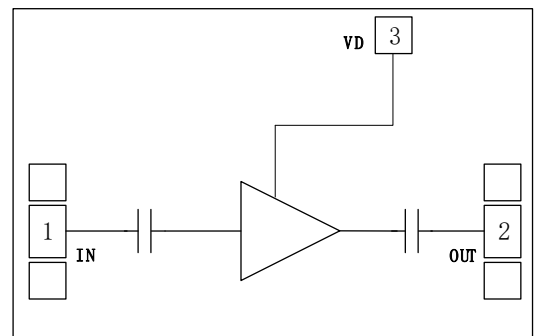
YLN173-0003B2 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 0.3~2.5GHz，小信号增益 23.5dB，噪声系数 0.7dB，输出 1dB 压缩功率 19dBm，饱和输出功率 20.5dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

### 关键技术指标

- 频率范围：0.3-2.5GHz
- 小信号增益：23.5dB
- 噪声系数：0.7dB
- 输入回波损耗：13dB
- 输出回波损耗：18dB
- 输出 1dB 压缩功率：19dBm
- 饱和输出功率：20.5dBm
- 输出三阶交调功率：29dBm
- 供电：+5V@40.5mA
- 芯片尺寸：1.80 mm × 1.25mm × 0.10mm

### 功能框图



### 电性能表 (T<sub>A</sub>=+25°C, V<sub>D</sub>=+5V)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	0.3	—	2.5	GHz
小信号增益	Gain	23.1	23.5	23.8	dB
增益平坦度	ΔG	—	±0.35	—	dB
噪声系数	NF	—	0.7	0.8	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	18.5	19	—	dBm
饱和输出功率	Psat	19.7	20.5	—	dBm
输出三阶交调功率*	OIP3	27.6	29	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	12	13	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	11	18	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	40.5	—	mA

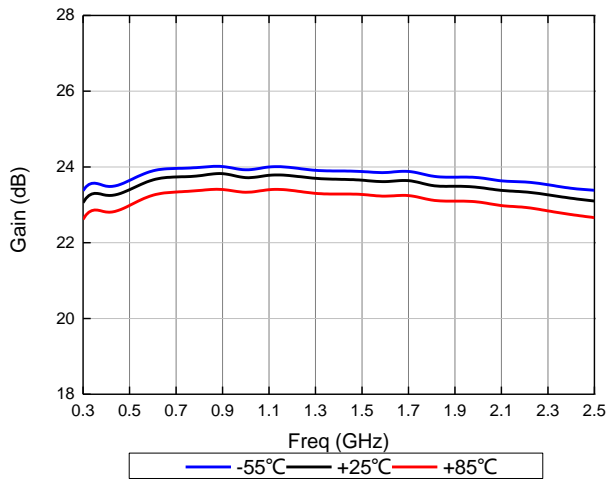
\*OIP3测试条件：PIN = -12dBm/tone，双音信号频率间隔1MHz

### 使用限制参数

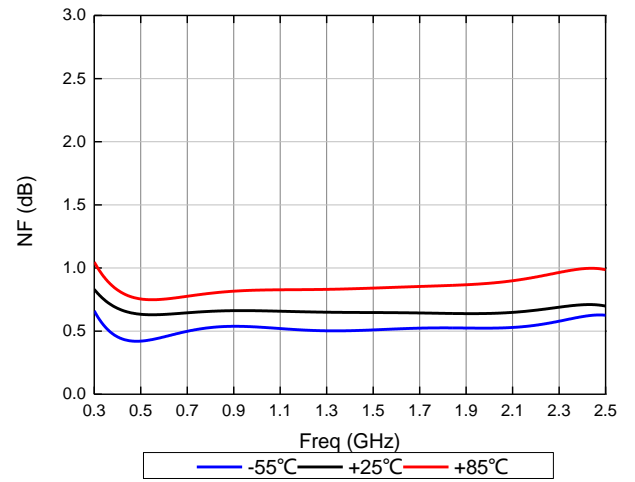
最大漏极工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 (VD=+5V)

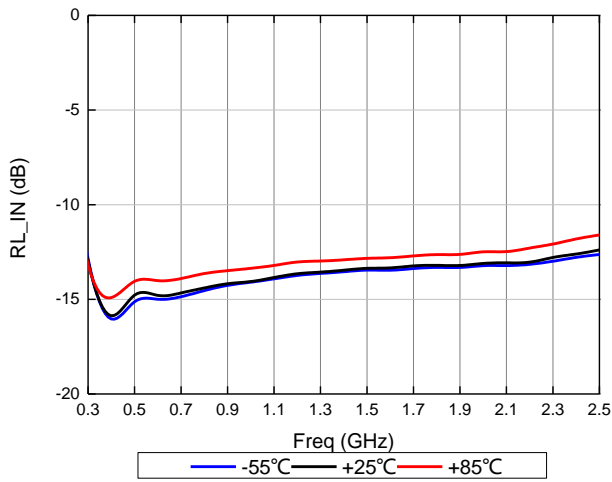
小信号增益



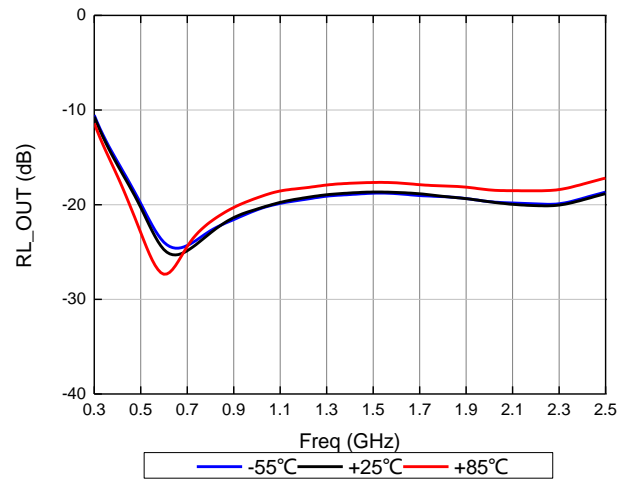
噪声系数



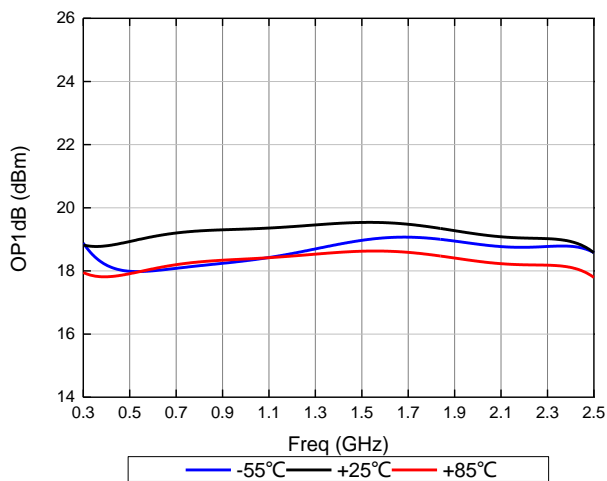
输入回波损耗



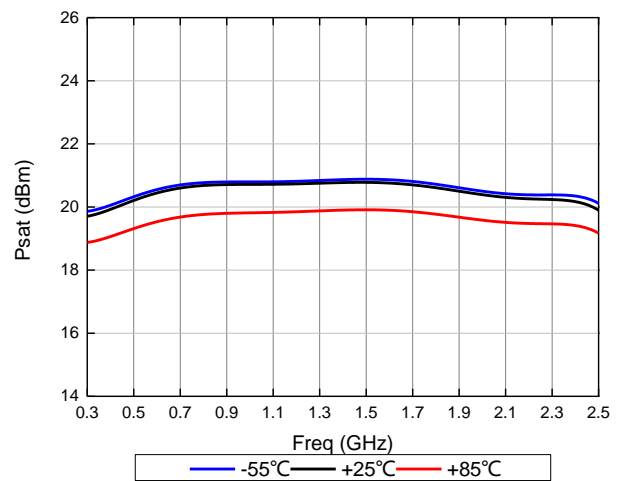
输出回波损耗



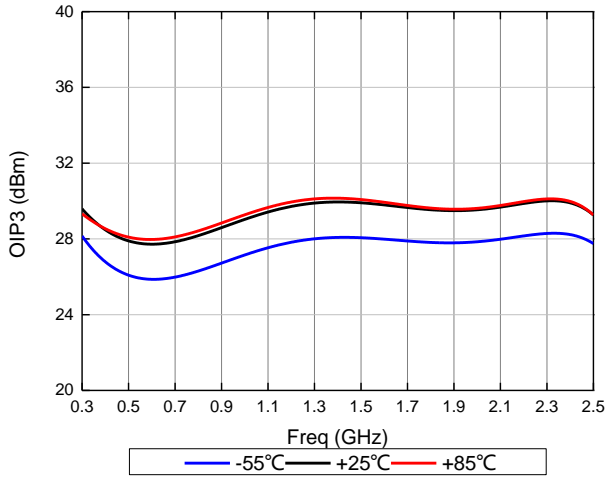
输出1dB压缩功率



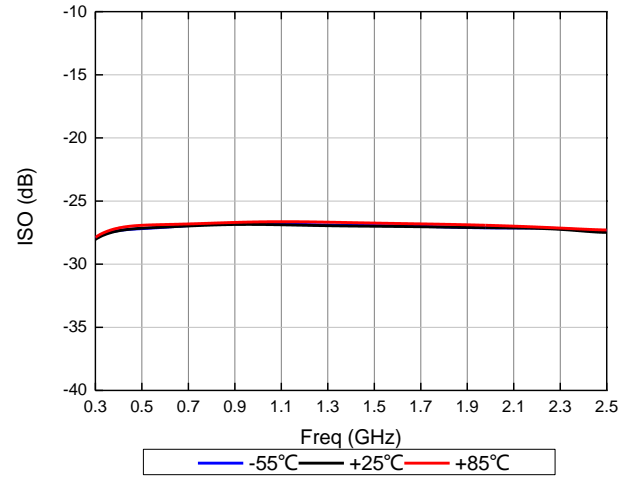
饱和输出功率



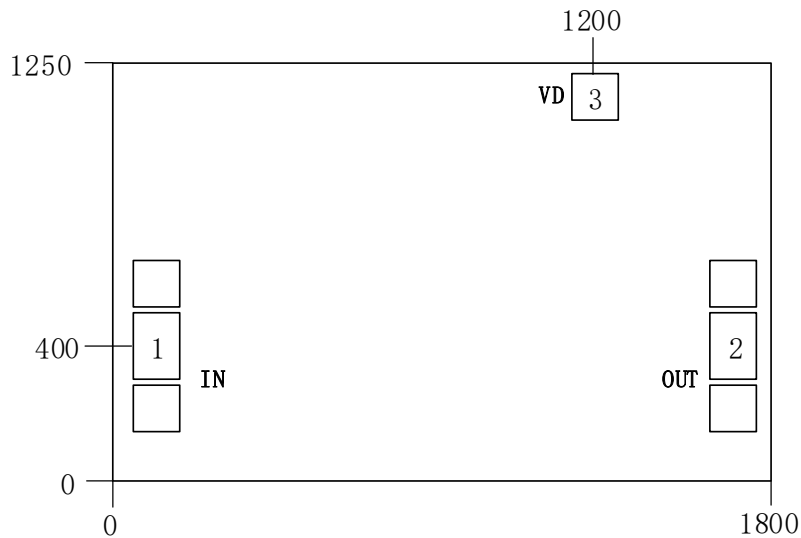
输出三阶交调功率



反向隔离度



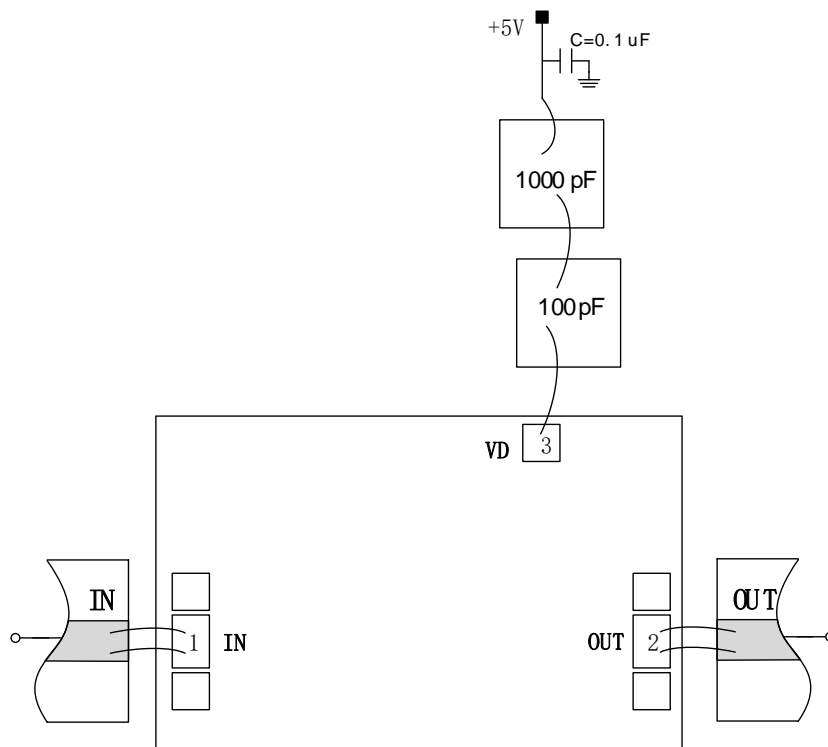
芯片端口图 (单位:  $\mu\text{m}$ )



端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入, 无需外接隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出, 无需外接隔直电容	RF
3	VD	LNA 漏极正电, 建议外加 100、1000pF 电容	+5V DC

## 建议装配图



## 注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径  $25\mu\text{m}$  金丝），键合线长度为  $400\mu\text{m}$  左右；
- 4) 烧结温度不要超过  $300^\circ\text{C}$ ，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。